

電子機器2025 トータルソリューション展

www.jpccashow.com



JPCA 2025 Show
第54回国際電子回路産業展

JIEP 2025
マイクロエレクトロニクスショー
第39回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC 2025
第26回 実装プロセステクノロジー展

AI Device Expo
AIデバイス展

W
～装置と装置をつなぐ～
WIRE Japan Show 2025
電気・光伝送技術展

Electronics Component & Unit Show
JEP 全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

E-Textile/Wearable
イーテキスタイル/ウェアラブル展

結果報告書

出展者数：442社 小間数：1,197小間 / 来場者数 49,760名

2025. 6. 4 Wed. → 6 Fri. 10:00-17:00

東京ビッグサイト 東展示棟 4～7ホール

www.jpccashow.com

本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2F TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org

展示会運営事務局：株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ (JCSC)

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-12-10 四国第二ビル TEL: 03-5931-0039 FAX: 03-3293-0505 E-mail: jpccashow@jcs-c.com

ご挨拶

「電子機器トータルソリューション展2025 (JPCA Show、マイクロエレクトロニクスショー、JISSO PROTEC、AIデバイス展、WIRE Japan Show、Electronics Component & Unit Show、E-Textile/Wearable)」は、2025年6月4日(水)～6月6日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催され、出展者数442社、出展小間数1,197小間で盛況裡に無事終了することができました。

これもひとえに、ご後援を賜りました経済産業省をはじめ、協賛団体各位、ご出展いただきました多くの企業の皆様のご支援とご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。

次回開催は、2026年6月10日(水)～6月12日(金)「電子機器トータルソリューション展2026」を東京ビッグサイト 東展示棟で予定しておりますので、ご出展・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ここに、今回の結果をご報告申し上げますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。



実施概要



展示会運営委員会
委員長
高井 建郎



(一社)日本電子回路工業会
会長
小林 俊文



(一社)エレクトロニクス実装学会
会長
日暮 栄治



(一社)日本ロボット工業会
会長
橋本 康彦



(株)産業タイムズ社
取締役会長
泉谷 渉



(株)工業通信
代表取締役社長
井上 政基



全国電子部品流通連合会
会長
屋宮 芳高



(株)織研新聞社
代表取締役社長
佐々木 幸二

■会 期：2025年6月4日(水)～6日(金)

■開催時間：10:00～17:00

■会 場：東京ビッグサイト東4～7ホール

■名 称：**JPCA Show 2025 第54回国際電子回路産業展**

構成展示会：2025 プリント配線板技術展
2025 半導体パッケージング・部品内蔵技術展
フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
2025 機器・半導体受託生産システム展

主 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)

JISSO PROTEC 2025

主 催：一般社団法人日本ロボット工業会

WIRE Japan Show 2025 電気・光伝送技術展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
電線新聞 ((株) 工業通信)

E-Textile/Wearable イーテキスタイル/ウェアラブル展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
株式会社織研新聞社

■後 援：経済産業省

■海外協力：世界電子回路業界団体協議会 (WECC) 加盟団体：

CPCA (中国電子回路産業協会)、EIPC (欧州電子回路協会)、ELCINA (印度電子工業会)、HKPCA (香港線路板協会)、

IPC (国際エレクトロニクス協会)、IPCA (印度電子回路工業会)、KPCA (韓国電子回路産業協会)、THPCA (タイ電子回路工業会)、TPCA (台湾電路板協会)

KPIA (Korea Packaging Integration Association)、AEIS (Association of Electronic Industries in Singapore)

■本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)

■協 賛：映像情報メディア学会、画像センシング技術研究会、画像電子学会、カメラ映像機器工業会、自動車技術会、日本フォトイメージング協会、情報サービス産業協会、情報処理学会、全国鍍金工業組合連合会、電気安全環境研究所、電気学会、電気設備学会、電子情報技術産業協会、電子情報通信学会、銅箔工業会、日印国際産業振興協会、日本アミューズメント産業協会、日本医療機器工業会、日本医療機器テクノロジー協会、日本印刷産業連合会、日本オーディオ協会、日本音響学会、日本火災報知機工業会、日本金型工業会、日本機械工業連合会、日本金属熱処理工業会、日本計量機器工業連合会、日本検査機器工業会、日本産業機械工業会、日本自動車研究所、日本自動車部品工業会、日本表面真空学会、日本真空工業会、日本精密測定機器工業会、日本電気協会、日本電気計測器工業会、日本電機工業会、日本電気制御機器工業会、日本照明工業会、日本電子部品信頼性センター、日本電線工業会、日本配線システム工業会、日本半導体製造装置協会、日本表面処理機材工業会、日本ファインセラミックス協会、日本分析化学会、日本分析機器工業会、日本ベアリング工業会、日本遊技関連事業協会、日本溶接協会、光産業技術振興協会、ビジネス機械・情報システム産業協会、表面技術協会、ファインセラミックスセンター、組込みシステム技術協会、技術研究組合光子融合基盤技術研究所、日本材料科学会、情報通信ネットワーク産業協会、ソフトウェア協会、日本電子デバイス産業協会、SEMI ジャパン、日本ドローンコンソーシアム (JDC)、日本 UAS 産業振興協議会 (JUIDA)、日本農業機械工業会 (JAMMA)、電気硝子工業会、日本ロボットシステムインテグレータ協会、計測自動制御学会、日本化学繊維協会

■展示会運営事務局：株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ (JCSC)

2025 マイクロエレクトロニクスショー 第39回 最先端実装技術・パッケージング展

同時開催：最先端実装技術シンポジウム

アカデミックプラザ

eX-tech 2025

主 催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)

AI Device Expo AI デバイス展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)

電子デバイス産業新聞 ((株) 産業タイムズ社)

Electronics Component & Unit Show

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)

全国電子部品流通連合会／東京都電機卸商業協同組合

スポンサーシップ

Platinum Sponsor



Gold Sponsor



Silver Sponsor



Bronze Sponsor



スポンサープログラムの主な内容

●会期前

メールマガジン広告（ヘッダ・センター）

●会期前～中

公式サイトトップページバナー

●会期中

ガレリアエスカレータ下デジタルサイネージへの広告掲載 / 会場入口デジタルサイネージへの広告掲載 / 開会式会場デジタルサイネージへのロゴ掲載 / 会場フロアマップへのロゴ掲載 / 基調講演スクリーンロゴ投影 / 会場内巡回自立走行型ロボットへの社名・ロゴ掲載 /

NEW 来場者データ取得サービス（1アカウント）

展示会結果概要

展示会・セミナーともに大盛況！

出展者数

442

社・団体

小間数

1,197

小間

来場者数

49,760名

セミナー数

180本

広報活動

(1) 関連業界団体との連携強化

メールマガジンの配信や機関誌への広告掲載など相互の展示会においてプロモーション活動を実施。

(2) 広告掲載媒体（順不同）

エレクトロニクス実装技術／メカトロニクス／プリント回路ジャーナル／織研新聞／電子デバイス新聞／電波新聞／電線新聞／化学工業日報／日刊工業新聞／プロダクトナビ／製品ナビ／基板の窓口

(3) 海外展示会出展・広告掲載実績

2024年	7月24日（水）～26日（金）	タイ：Thailand Electronics Circuit Asia 2024
	9月4日（水）～6日（金）	韓国：KPCA Show 2024
	10月23日（水）～25日（金）	台湾：TPCA Show 2024
	11月6日（水）～8日（金）	中国：国際電子回路（グレーターベイエリア）展覧会
	11月6日（水）・7日（木）	中国：日中電子回路秋季大会
	12月4日（水）～6日（金）	香港：国際電子回路（深圳）展覧会2024
2025年	3月15日（土）～20日（木）	米国：IPC Apex Expo
	3月24日（月）～26日（水）	中国：CPCA Show 2025

(4) PRツール製作

国内用招待状（データ配布）、海外用招待状（データ配布）、VIP招待券（51,000枚）、ポスター（700枚）

(5) メールマガジンの配信

関連する業界団体やスポンサー企業などの協力により、会期1ヶ月前よりメールマガジン配信を実施。

(6) メディア発表会の実施

昨年に引きつづき、開幕に先駆け、5月20日（火）よりオンラインにてメディア発表会を実施。



開会式

●日 時：6月4日（水）9:45～10:00

●会 場：東京ビッグサイト 東5ホールガレリア

来賓	西村 秀隆	経済産業省	審議官（商務情報政策局担当）
開催挨拶	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
	高井 建郎	一般社団法人日本電子回路工業会	展示会運営委員会委員長
	日暮 栄治	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長
	橋本 康彦	一般社団法人日本ロボット工業会	会長
	泉谷 渉	株式会社産業タイムズ社	取締役会長
	井上 政基	株式会社工業通信	代表取締役社長
	屋宮 芳高	全国電子部品流通連合会	会長
	久本 正大	株式会社織研新聞社	大阪支社長
	LUO CHUNFENG	中国電子回路行業協会（CPCA）	副会長
	Luther WONG	香港線路板協会（HKPCA）	副会長
	David Bergman	国際エレクトロニクス協会（IPC）	国際関係担当副社長
	Jong Hak Kim	韓国電子回路産業協会（KPCA）	副会長
	Wutthinan Jeamsaksiri	タイ電子回路工業会（THPCA）	理事
	Lawrence Chang	台湾電路板協会（TPCA）	理事長



ウェルカムレセプション

出展企業及び業界関係者約300名が参加。御来賓として、経済産業大臣 政務官 竹内 真二様にご挨拶をいただいた。

●日 時：6月4日（水）17:30～18:30

●会 場：東京ビッグサイト 東7ホール内セミナー会場A（基調講演会場）

挨拶	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
来賓挨拶	竹内 真二	経済産業省	大臣政務官
乾杯登壇	竹内 真二	経済産業省	大臣政務官
	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
	高井 建郎	一般社団法人日本電子回路工業会	展示会運営委員会委員長
	日暮 栄治	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長
	高橋 良太郎	一般社団法人日本ロボット工業会	理事
	泉谷 渉	株式会社産業タイムズ社	代表取締役会長
	井上 政基	株式会社工業通信	代表取締役社長
	松本 年生	全国電子部品流通連合会	専務理事
	久本 正大	株式会社織研新聞社	取締役業務局長兼大阪支社長
	山下 博樹	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	小島 正紀	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	倉田 司	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
乾杯発声	高橋 良太郎	一般社団法人日本ロボット工業会	理事
中締挨拶	日暮 栄治	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長



開会式テープカット



竹内経済産業大臣政務官ご挨拶



ウェルカムレセプション鏡開き



学生向けオリエンテーション&ツアー

学生の皆様へ業界についての深い知識と理解を得ていただくために展示会オリエンテーション&ツアーを実施いたしました。
学生の皆様のお立ち寄りを特に歓迎する出展者様には“学生ウェルカムブース”としてご参加いただきました。

●日 時：各日とも 10:30～11:00 オリエンテーション / 11:00～12:00 展示会ツアー



ブースコンテスト

前回に引き続きブースコンテストを実施いたしました。

ブースコンテストは、出展企業の中から、ブースデザインの装飾を対象とした【ナイスデザイン賞】、パッケージブースの効果的利用を対象とした【特別審査員賞】の2つの賞を設け、来場者投票により決定しました。

表彰式 ●日 時：6月6日（金）10:15 ～ 10:30 ●会 場：東7ホール内セミナー会場A



ナイスデザイン賞

【小間番号：6G-01】
太陽インキ製造株式会社



特別審査員賞

【小間番号：4B-10】
株式会社イチネン製作所



デモンストレーション／体験

●脳波ゲーム体験 —あなたの今を色で表現—

技術提供：(株)アラヤ/Visionary Lab『Colors』、大阪大学 関谷研究室、PGV株式会社

脳波計と調色照明を利用したゲーム体験“Colors”を体験できるコーナーにて1日4回の枠を設け、ババ抜きをした駆け引きにおいて、色で表現した心理状態が見える体験をしていただきました。

●安全なモノづくりは健康管理から—簡単な測定で心と身体の状態を知り、無理なく働くヒントに—

技術提供：(株)村田製作所、(一社)スポーツ能力発見協会

体験と併せて3日間セミナー「疲労ストレス計MF100による自律神経状態の見える化とその活用例」が開催されました。



会場レイアウト

東7ホール

JPCA Show

- 7A-01 フジエレクトロニクス
- 7A-02 日本サーキット
- 7A-04 ローデック・ジャパン
- 7B-01 コネクテッド・ジャパン
- 7B-02 富士プリント工業/アポロ技術/フェイス/ボルクテック/富士回路科技
- 7B-03 ミクナスDTソリューションズ
- 7B-04 スマート・ソリューション・テクノロジー
- 7B-05 オンテック
- 7D-01 奥野製工業
- 7D-02 TOIPAN
- 7D-03 日放電子
- 7D-04 新光電子
- 7D-05 Shenzhen Technology Trust Precision Industry
- 7D-06 内藤電機工業
- 7D-07 TOWA
- 7D-08 日機装
- 7E-10 CPCA (中国電子回路産業協会)
- 7E-11 THPCA (タイ電子回路工業会)
- 7E-12 IPC (国際エレクトロニクス協会)
- 7E-13 TPCA (台湾回路板協会)
- 7F-01 三井金属鉱業
- 7F-02 クボテック
- 7F-03 日本電気硝子
- 7F-19 アラヤ Visionary Lab
- 7F-20 大阪大学
- 7G-01 オックスフォード・インストールメンツ
- 7G-02 リコルジャパン
- 7G-03 サカイクンクス
- 7G-04 東洋アルミニウム
- 7G-05 マクセル
- 7G-06 フォアサイト/ニチワ工業
- 7G-07 東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室
- 7G-09 三井化学分析センター
- 7G-10 STAR-/KASTON
- 7G-11 高田工業所
- 7G-13 ワンダーフューチャーコーポレーション/協立化学産業
- 7G-14 エクシール
- 7G-29 KPCA (韓国電子回路産業協会)
- 7G-30 Tangshan Huixun Electronic Technology
- 7G-31 HKPCA (香港回路板協会)
- 7G-34 村田製作所
- 7H-01 韓国実装産業協会 (KPIA)
- 7H-02 清川メッキ工業
- 7H-01 日本電子回路工業会 (JPCA)
- 7H-02 日刊工業新聞社
- 7H-03 インコム
- 7H-04 熊本県
- 7H-05 プリント回路ジャーナル
- 7H-06 いのちを守る@プロジェクトJAPAN
- 7H-07 ヨクスル
- 7H-01 化学工業日報社
- 7H-02 電子情報技術産業協会 (JEITA)

3D-MIDパビリオン

- 7G-17 太陽インキ製造
- 7G-18 図研
- 7G-19 日本MID協会
- 7G-20 マクセル
- 7G-21 岩手県工業技術センター
- 7G-22 ワンダーフューチャーコーポレーション

チップレット展

- 7F-04 丸文
- 7F-08 ハイデルベルグ・インストールメンツ

AIデバイス展

- 7F-05 シストランジャパン
- 7F-06 Leaner Technologies
- 7F-07 産業タイムズ社
- 7F-18 ZENKEN

E-Textile/Wearable展

- 7A-13-1 ユシロ
- 7A-13-2 ENEOSテクノマテリアル
- 7A-13-3 フジックス
- 7A-13-4 ミツバ
- 7A-13-5 中津山熱処理
- 7A-13-6 テキスタイル製品化研究会
- 7A-13-7 東京都立産業技術研究センター
- 7A-13-8 hap
- 7A-13-9 セプト研究所・サイフォンフールベルト
- 7A-13-10 ヨコフ FC事業部
- 7A-13-11 レクタ
- 7A-13-12 フューチャーブランド
- 7C-07-1 米澤物産
- 7C-07-2 ウラセ
- 7C-07-3 陸上自衛隊 化学学校
- 7C-07-3 JPCA E-Textile ワーキンググループ

スピーカーラウンジ

7I-01

7I-02

7I-03

7I-04

7I-05

7I-06

7I-07

7I-08

7I-09

7I-10

7I-11

7I-12

7I-13

7I-14

7I-15

7I-16

7I-17

7I-18

7I-19

7I-20

7I-21

7I-22

7I-23

7I-24

7I-25

7I-26

7I-27

7I-28

7I-29

7I-30

7I-31

7I-32

7I-33

7I-34

7I-35

7I-36

7I-37

7I-38

7I-39

7I-40

7I-41

7I-42

7I-43

7I-44

7I-45

7I-46

7I-47

7I-48

7I-49

7I-50

7I-51

7I-52

7I-53

7I-54

7I-55

7I-56

7I-57

7I-58

7I-59

7I-60

7I-61

7I-62

7I-63

7I-64

7I-65

7I-66

7I-67

7I-68

7I-69

7I-70

7I-71

7I-72

7I-73

7I-74

7I-75

7I-76

7I-77

7I-78

7I-79

7I-80

7I-81

7I-82

7I-83

7I-84

7I-85

7I-86

7I-87

7I-88

7I-89

7I-90

7I-91

7I-92

7I-93

7I-94

7I-95

7I-96

7I-97

7I-98

7I-99

7I-100

7I-101

7I-102

7I-103

7I-104

7I-105

7I-106

7I-107

7I-108

7I-109

7I-110

7I-111

7I-112

7I-113

7I-114

7I-115

7I-116

7I-117

7I-118

7I-119

7I-120

7I-121

7I-122

7I-123

7I-124

7I-125

7I-126

7I-127

7I-128

7I-129

7I-130

7I-131

7I-132

7I-133

7I-134

7I-135

7I-136

7I-137

7I-138

7I-139

7I-140

7I-141

7I-142

7I-143

7I-144

7I-145

7I-146

7I-147

7I-148

7I-149

7I-150

7I-151

7I-152

7I-153

7I-154

7I-155

7I-156

7I-157

7I-158

7I-159

7I-160

7I-161

7I-162

7I-163

7I-164

7I-165

7I-166

7I-167

7I-168

7I-169

7I-170

7I-171

7I-172

7I-173

7I-174

7I-175

7I-176

7I-177

7I-178

7I-179

7I-180

7I-181

7I-182

7I-183

7I-184

7I-185

7I-186

7I-187

7I-188

7I-189

7I-190

7I-191

7I-192

7I-193

7I-194

7I-195

7I-196

7I-197

7I-198

7I-199

7I-200

7I-201

7I-202

7I-203

7I-204

7I-205

7I-206

7I-207

7I-208

7I-209

7I-210

7I-211

7I-212

7I-213

7I-214

7I-215

7I-216

7I-217

7I-218

7I-219

7I-220

7I-221

7I-222

7I-223

7I-224

7I-225

7I-226

7I-227

7I-228

7I-229

7I-230

7I-231

7I-232

7I-233

7I-234

7I-235

7I-236

7I-237

7I-238

7I-239

7I-240

7I-241

7I-242

7I-243

7I-244

7I-245

7I-246

7I-247

7I-248

7I-249

7I-250

7I-251

7I-252

7I-253

7I-254

7I-255

7I-256

7I-257

7I-258

7I-259

7I-260

7I-261

7I-262

7I-263

マイクロエレクトロニクスショー

アカデミックプラザ

- 7A-05 崇城大学
- 7A-06 東北大学 日暮研究室
- 7A-07 東北大学
- 7A-08 群馬大学大学院 理工学府
- 7A-09 大阪大学
- 7A-10 日本大学理工学部精密機械工学科
- 7A-11 日本大学 金子研究室
- 7A-12 山口東京理科大学
- 7B-06 東京理科大学
- 7B-07 公立諏訪東京理科大学 地域連携研究開発機構
- 7B-08 大阪公立大学
- 7B-09 電磁材料研究所
- 7B-10 愛媛大学大学院理工学研究科
- 7B-11 足利大学
- 7B-12 電気通信大学
- 7B-13 信州大学
- 7B-14 国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 中山研究室
- 7B-15 神奈川県立産業技術総合研究所
- 7B-16 山形県工業技術センター
- 7B-17 公立千歳科学技術大学
- 7C-01 群馬大学
- 7C-03 山形大学
- 7C-04 北海道大学
- 7C-05 横浜国立大学
- 7C-06 東京工芸大学

eX-tech

- 7D-09 アンドールシステムサポート
- 7D-10 サイバネットシステム
- 7D-11 I-PEX
- 7D-12 電子技研
- 7D-13 イープロニクス
- 7D-14 日本高純度化学
- 7D-15 品孔技研
- 7D-16 JNC石油化学
- 7D-17 エキシルム AB
- 7D-18 TDK
- 7D-19 奥野製薬工業
- 7E-01 大阪有機化学工業
- 7E-02 CHEMIPAZ(旧社名:星光 PMC)
- 7E-03 大洋工作所
- 7E-04 ノードソン
- 7E-05 テクニトロン・サプライ
- 7E-06 カネカテクノリサーチ
- 7E-07 エンジニアリング・ラボ
- 7E-08 日邦産業
- 7E-09 KMT技研
- 7F-09 プラスマイオンアシスト
- 7F-10 長瀬産業
- 7F-11 エスベック
- 7F-12 ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン
- 7F-13 アテネ
- 7F-14 秋田化学工業
- 7F-15 ハニー化成
- 7F-16 電気印刷研究所
- 7F-17 パナック

- 7G-15 リケンNPR
- 7G-16 TEGソリューション
- 7G-26 エレクトロニクス実装学会(JIEP)
- 7G-27 サンエレクトロニクス
- 7G-28 ミカドテクノス



JPCA賞・JPCA奨励賞 受賞出展者



学生 学生ウェルカムブース
(2025年5月22日現在)



ELC支持企業・団体

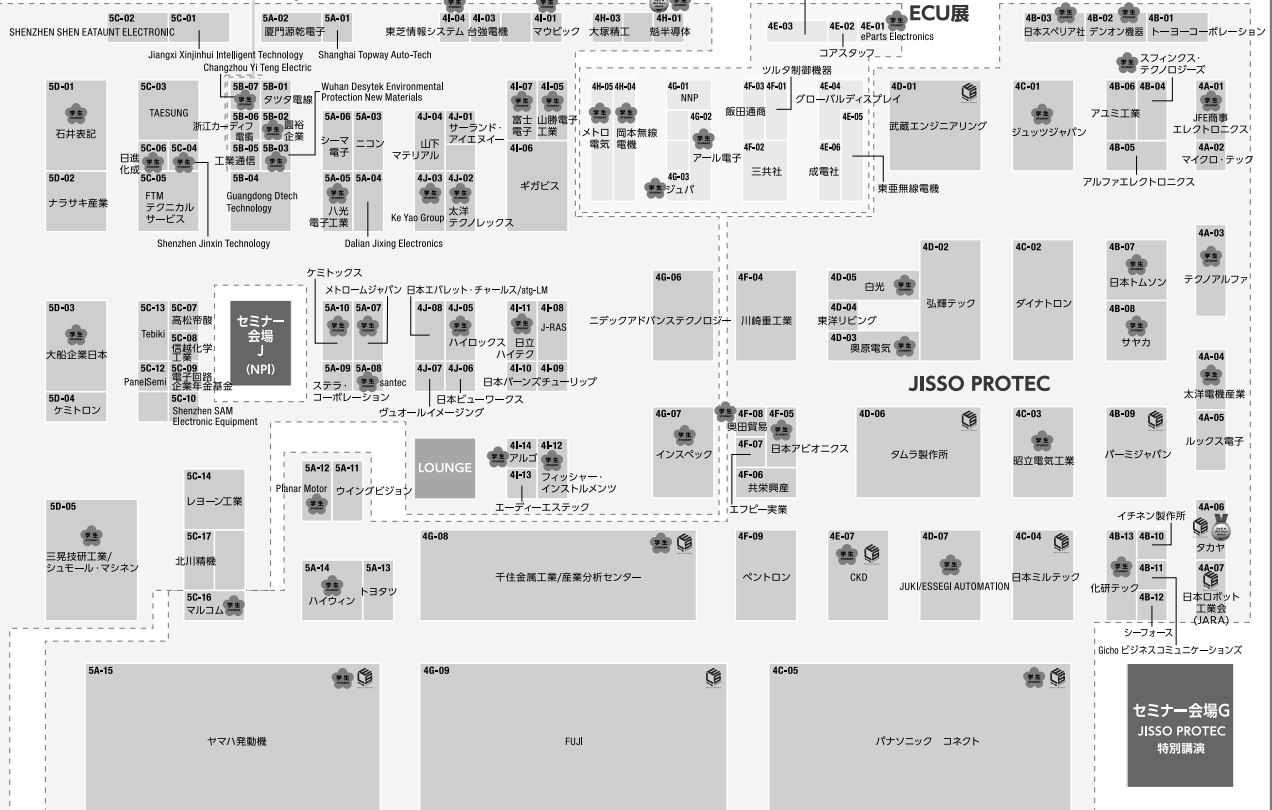
セミナー会場H

セミナー会場K

東4ホール

WIRE Japan Show

全国電子部品流通連合会 (JEP) / 東京都電機卸商業協同組合 (TEP)





出展者一覧

JPCA Show

プリント記線板技術展

愛工機器製作所	6E-07
相信	6J-05
アイン	6I-10
赤羽産業	6D-02
旭化成	6B-01
アスリートFA	5F-06
アドウェルズ	5I-11
アドテックエンジニアリング	5E-02
アトテックジャパン	6D-01
アポロ技研	7B-02
アラヤ Visionary Lab	7F-19
アルゴ	4I-14
アルメックステクノロジーズ	6D-04
イー・エス・アイジャパン	6D-01
EME	6I-07
石井表記	5D-01
石原ケミカル	5G-05
イチカワテクノファブリクス	5H-05
いのちを守る @ プロジェクト JAPAN	7I-06
伊原電子工業	6J-07
インコム	7I-03
インスペック	4G-07
上村工業	6A-02
ウシオ電機	5F-05
ヴェオールイメージング	4J-07
EIZO	5I-13
エイト工業	6I-15
エーディーエステック	4I-13
エステック	6B-07
NTW Inc.	6F-07
FTM テクニカルサービス	5C-05
オーク製作所	6F-08
大阪大学	7F-20
大船企業日本	5D-03
オカダジーエーエー	5I-12
オンテック	7B-05
化学工業日報社	7J-01
亨通	5I-04
笠原理化学工業	5I-02
華正新材料	6I-04
北川精機	5C-17
協栄プリント技研	5F-02
京写	6H-10
キョウデン	6E-02
共立エレクトックス	5I-05
金陽社	5I-06
熊本県	7I-04
クラボウ	6C-06
クラレ	6I-05
黒金化成	6I-06
ケミックス	5A-10
ケミトロニクス	5H-06
ケミロン	5D-04
江蘇蘇杭電子	6I-11
相模ピーシーアイ	6I-09
ZACROS	6H-07
佐藤商事	6B-10
山栄化学	5F-03
三晃技研工業	5D-05
サンテック	5G-01
santec	5A-08

GIS Tech	6B-08
シーエスワイ	5H-06
JSR	6J-01
JCU	5H-03
J-RAS	4I-08
四国化成工業	5F-01
澁谷工業	5G-08
ジャブロ工業	6B-03
上海山崎電路板	6J-09
松和産業	6E-05
ショーダテクトロン	5I-09
シライ電子工業 国内・海外営業本部	6F-06
シライ電子工業 ソリューション事業本部	6A-05
信越化学工業	5C-08
真華成	5I-10
伸光製作所	6G-08
新興電気	5E-04
SCREEN GP ジャパン	6G-11
SCREEN PE エンジニアリング	6G-11
SCREEN PE ソリューションズ	6G-11
SCREEN ホールディングス	6G-11
ステラ	5E-04
ステラ・コーポレーション	5A-09
スマート・ソリューション・テクノロジー	7B-04
セリアコーポレーション	6C-05
大日光・エンジニアリング	6H-11
太陽インキ製造	6G-01
ダイワ	5F-08
ダイワ工業	6H-12
高千穂交易	6H-14
高松帝酸	5C-07
タケウチ	6A-06
田原電機製作所	6H-13
ちの技研	6I-13
チューリップ	4I-09
長興材料工業	6C-01
角田ブラシ製作所	5G-04
ティーシーティー・ジャパン	5I-08
DDP スペシャルティ・プロダクツ・ジャパン	6C-03
Tebiki	5C-13
デンカ	6G-02
電気化学システムズ	5G-07
電子回路企業年金基金	5C-09
電子情報技術産業協会 (JEITA)	7J-02
東海神栄電子工業	6I-12
東京マシン・アンド・ツール	5E-04
東光技研工業	5G-06
東レ・デュボン	6J-04
トーア電子	5G-01
巴工業	6J-02
ナラサキ産業	5D-02
ニチアス	6J-03
ニッカン工業	6H-01
日刊工業新聞社	7I-02
ニッコー・マテリアルズ	6C-01
日駿	6E-03
日進化成	5C-06
ニデックアドバンステクノロジー	4G-06
日本アグフマテリアルズ	6B-04
日本エパレット・チャールス	4J-08
日本化学工業	6A-01
日本サーキット	7A-02
日本製鋼所	5G-02
日本テルペン化学	5I-07

日本電子回路工業会 (JPCA) 書籍販売コーナー	7I-01
日本電波	6J-06
日本パーンズ	4I-10
日本ビューワークス	4J-06
ハイケム	6H-06
ハイロックス	4J-05
伯東	5E-01
パスカン	6H-15
ピアメカニクス	5E-04
日立ハイテック	4I-11
平山ファインテクノ	6F-04
ファインテック	6B-06
フィッシャー・インストルメンツ	4I-12
ブイ・テクノロジー	5E-03
フェイス	7B-02
福田金属箔粉工業	6H-02
不二越	6B-10
富士プリント工業	7B-02
プリント回路ジャーナル	7I-05
ブルックスジャパン	5H-09
ベアック	6D-03
ボルックステクノ	7B-02
マイクロクラフト	6D-05
マコー	5F-07
マックエイト	6I-15
丸源鐵工所	5H-08
丸文	6A-04
ミクナス DT ソリューションズ	7B-03
マイクロ技術研究所	5G-03
三菱ガス化学	6F-01
三菱電機	5H-10
ムラキ	6B-09
村田製作所	7G-34
メイコー	6E-01
メック	6B-05
メトロームジャパン	5A-07
モトロニクス	5G-06
ユニオンツール	6H-03
ヨクスル	7I-07
ヨシミツ理化	6G-06
ライズエレクトロニクス	6E-04
利昌工業	6G-03
令和マテリアル	5H-06
レヨーン工業	5C-14
ローデ・シュワルツ・ジャパン	7A-04
ACCUTECH (SHENZHEN)	6A-03
Addison Clear Wave Coating	5H-01
atg luther & maelzer	4J-08
CHEON WESTERN (CHINA) GROUP	6G-05
China Circuit Technology (Shantou)	6G-04
CPCA (中国電子回路工業協会)	7E-10
東莞市同亞電子科技	5H-02
鋭豊企業	6D-02
四会富仕電子科技	6G-07
富士電路科技	7B-02
榮信 (香港) 電路板	6E-06
Goal Searchers Zhuhai	6C-04
群翊工業	5H-06
広東駿亜電子科技	6E-03
广东伊帕思新材料科技	6H-09
Guangdong Yinghua Electronic Materials	6I-01
HKPCA (香港線路板協会)	7G-31
IPC (国際エレクトロニクス協会)	7E-12
江西江南新材料科技	6F-03

Jiangxi Xinjinhui Intelligent Technology	5C-01
建滔积层板	6E-04
KPCA（韓国電子回路産業協会）	7G-29
PanelSemi	5C-12
PCBGOGO	6F-05
PCBWay	6G-10
億鴻工業	6D-02
シュモール・マシネン	5D-05
SET	6A-04
Shandong Shengquan Electronics Materials	6I-02
Shenzhen Han's CNC Technology	6I-16
Shenzhen JCD Circuit Tech	5I-01
Shenzhen Jinxin Technology	5C-04
SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY	6C-02
Shenzhen Junze Environmental Technology	6F-02
Shenzhen Londian Wason Technology	6I-03
深圳メイソン電子	6I-16
深圳市ニューセス実業	6B-02
Shenzhen SAM Electronic Equipment	5C-10
SHENZHEN SHEN EATAUNT ELECTRONIC	5C-02
Shenzhen SUREU Technology	5I-03
SHENZHEN TIANXI SCIENCE DEVELOPMENT	6H-04
ShenZhen XinJiaYe Electronics Technology	5F-04
嵩台資訊	5H-08
Sunshine Global Circuits	6H-08
碩頂精密工業	5H-04
Suzhou Tztek Technology	5H-07
TAESUNG	5C-03
台湾軟電	6G-09
TPCA（台湾電路板協会）	7E-13
提凱貿易（上海）	6H-14
科惠（澳門）線路	6E-04
THPCA（タイ電子回路工業会）	7E-11
偉勝乾燥工業	6D-02
盈華電子科技	6H-05
Yiyang Jindong Technology	6F-02
ZHEJIANG EMIDA PUMPS	5I-10
3D-MID パビリオン	
地方独立行政法人 岩手県工業技術センター	7G-21
図研	7G-18
太陽インキ製造	7G-17
日本 MID 協会	7G-19
マクセル	7G-20
ワンダーフューチャーコーポレーション	7G-22
半導体パッケージング・部品内蔵技術展	
エクシール	7G-14
奥野製薬工業	7D-01
オックスフォード・インストゥルメンツ	7G-01
協立化学産業	7G-13
清川メッキ工業	7H-02
クボテック	7F-02
コネクテックジャパン	7B-01
サカタインクス	7G-03
新光電子	7D-04
STAR-J	7G-10
高田工業所	7G-11
東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室	7G-07
東洋アルミニウム	7G-04
TOWA	7D-07
TOPPAN	7D-02
内藤電誠工業	7D-06
ニチワ工業	7G-06
日機装	7D-08
日放電子	7D-03

日本電気硝子	7F-03
フォアサイト	7G-06
フジ機工	7A-01
マクセル	7G-05
三井化学分析センター	7G-09
三井金属鉱業	7F-01
リゴルジャパン	7G-02
ワンダーフューチャーコーポレーション	7G-13
KASTON	7G-10
韓国実装産業協会 (KPIA)	7H-01
Shenzhen Technology Trust Precision Industry	7D-05
Tangshan Huixun Electronic Technology	7G-30
フレキシブルプリント配線板製品出展エリア	
サーランド・アイエヌイー	4J-01
シーマ電子	5A-06
太洋テクノレックス	4J-02
タツタ電線	5B-01
ニコン	5A-03
八光電子工業	5A-05
山下マテリアル	4J-04
圓裕企業	5B-02
Dalian Jixing Electronics	5A-04
Guangdong Dtech Technology	5B-04
Ke Yao Group	4J-03
Shanghai Topway Auto-Tech	5A-01
Wuhan Desytek Environmental Protection New Materials	5B-03
廈門源乾電子	5A-02
機器・半導体受託生産システム展	
大塚精工	4H-03
ギガビス	4I-06
魁半導体	4H-01
東芝情報システム	4I-04
富士電子	4I-07
マウビック	4I-01
山勝電子工業	4I-05
台強電機	4I-03

マイクロエレクトロニクスショー

エレクトロニクス実装学会 (JIEP)	7G-26
サンエナジー	7G-27
TEGソリューション	7G-16
ミカドテクノス	7G-28
リケン NPR	7G-15
eX-tech	
I-PEX	7D-11
秋田化学工業	7F-14
アテネ	7F-13
アンドールシステムサポート	7D-09
イープロニクス	7D-13
エスベック	7F-11
エンジニアリング・ラボ	7E-07
大阪有機化学工業	7E-01
奥野製薬工業	7D-19
カネカテクノリサーチ	7E-06
KMT技研	7E-09
CHEMIPAZ（旧社名：星光 PMC）	7E-02
サイバネットシステム	7D-10
JNC 石油化学	7D-16
晶孔技研	7D-15
太洋工作所	7E-03
ティー・エイ・インストゥルメント・ジャパン	7F-12
TDK	7D-18
テクニトロン・サプライ	7E-05
電気印刷研究所	7F-16

電子技研	7D-12
長瀬産業	7F-10
日邦産業	7E-08
日本高純度化学	7D-14
ノードソン	7E-04
パナック	7F-17
ハニー化成	7F-15
プラズマイオンアシスト	7F-09
エキシルム AB	7D-17
アカデミックプラザ	
足利大学	7B-11
愛媛大学大学院理工学研究科	7B-10
大阪公立大学	7B-08
大阪大学	7A-09
群馬大学	7C-01
群馬大学大学院 理工学府	7A-08
公立諏訪東京理科大学 地域連携研究開発機構	7B-07
公立千歳科学技術大学	7B-17
国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 中山研究室	7B-14
信州大学	7B-13
崇城大学	7A-05
神奈川県立産業技術総合研究所	7B-15
電気通信大学	7B-12
電磁材料研究所	7B-09
東京工芸大学	7C-06
東京理科大学	7B-06
東北大学	7A-07
東北大学 日暮研究室	7A-06
日本大学 金子研究室	7A-11
日本大学理工学部精密機械工学科	7A-10
北海道大学	7C-04
山形県工業技術センター	7B-16
山形大学	7C-03
山口東京理科大学	7A-12
横浜国立大学	7C-05

JISSO PROTEC

アユミ工業	4B-06
アルファエレクトロニクス	4B-05
イチネン製作所	4B-10
ウイングビジョン	5A-11
エフピー実業	4F-07
奥田貿易	4F-08
奥原電気	4D-03
化研テック	4B-13
川崎重工業	4F-04
Gicho ビジネスコミュニケーションズ	4B-11
共栄興産	4F-06
弘輝テック	4D-02
サヤカ	4B-08
産業分析センター	4G-08
CKD	4E-07
シーフォース	4B-12
JFE 商事エレクトロニクス	4A-01
JUKI	4D-07
ジュッツジャパン	4C-01
昭立電気工業	4C-03
スフィックス・テクノロジーズ	4B-04
千住金属工業	4G-08
ダイナトロン	4C-02
太洋電機産業	4A-04
タカヤ	4A-06
タムラ製作所	4D-06
テクノアルファ	4A-03



出展者一覧

※五十音順／法人格省略

デンオン機器	4B-02
東洋リビング	4D-04
トーヨーコーポレーション	4B-01
トヨタ	5A-13
日本アビオニクス	4F-05
日本スペリア社	4B-03
日本トムソン	4B-07
日本ミルテック	4C-04
日本ロボット工業会（JARA）	4A-07
パーミジヤパン	4B-09
ハイウィン	5A-14
白光	4D-05
パナソニック コネクト	4C-05
FUJI	4G-09
マイクロ・テック	4A-02
マルコム	5C-16
武蔵エンジニアリング	4D-01
ヤマハ発動機	5A-15
ルックス電子	4A-05
ESSEGI AUTOMATION	4D-07
ペントロン	4F-09
Planar Motor	5A-12

AI Device Expo

産業タイムズ社	7F-07
シストランジャパン	7F-05
Zenken	7F-18
Leaner Technologies	7F-06

WIRE Japan Show

工業通信	5B-05
Changzhou Yi Teng Electric	5B-07
Zhejiang Cardiff Cable	5B-06

Electronics Component & Unit Show

アール電子	4G-02
飯田通商	4F-03
eParts Electronics	4E-01
NNP	4G-01
岡本無線電機	4H-04
グローバルディスプレイ	4E-04
コアスタッフ	4E-02
三共社	4F-02
ジュパ	4G-03
成電社	4E-06
全国電子部品流通連合会（JEP）	4E-03
ツルタ制御機器	4F-01
東亜無線電機	4E-05
東京都電機卸商業協同組合（TEP）	4E-03
メトロ電気	4H-05

E-Textile/Wearable

ウラセ	7C-07-2
ENEOS テクノマテリアル	7A-13-2
三機コンシス	7A-13-7
JPCA E-Textile ワーキンググループ	7C-07-3
セフト研究所	7A-13-9
t-テキスタイル製品化研究会	7A-13-6
東京都立産業技術研究センター	7A-13-6
中津山熱処理	7A-13-5
hap	7A-13-8
フジックス	7A-13-3
フューチャーブランド	7A-13-12
ミツヤ	7A-13-4

ユシロ	7A-13-1
ヨコオ FC 事業部	7A-13-10
米澤物産	7C-07-1
陸上自衛隊 化学学校	7C-07-3
レクア	7A-13-11

チップレット展

ハイデルベルグ・インストルメンツ	7F-08
丸文	7F-04



電子機器トータルソリューション展 基調講演

無料

●日 時：6月4日（水）～6日（金） ●会 場：セミナー会場 A ●聴講者数：全6セッション 1,627名

6月4日（水）	10:30 }		AIと半導体が世界経済を引っ張る主役の時代がやって来た！ ～後工程の重要性、チップレット、パッケージ基板の高度化に注目～
	11:20		
	11:30 }		未来を創る最先端半導体パッケージング技術
	12:20		

泉谷 渉 (株)産業タイムズ社 取締役 会長

荒木 康 新光電気工業(株) 開発統括部 上席執行役員 開発統括部長

6月5日（木）	10:30 }		日本の半導体戦略の現状と今後
	11:20		
	11:30 }		IBM 地域 DX センターが掲げる産官学共創と人材育成 ～チップレット・AI半導体・工場自動化などへの展開～
	12:20		

清水 英路 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室 室長

山之口 裕一 日本アイ・ビー・エム(株) 製造・流通・公益・統括サービス事業部 事業部長・常務執行役員

6月6日（金）	10:30 }		AFEELAにおけるモビリティの新たな価値基準の創造
	11:20		
	11:30 }		脳が語る未来： 柔軟・伸縮性エレクトロニクスが拓く新たな生体センシング
	12:20		

川西 泉 ソニー・ホンダモビリティ(株) 代表取締役社長 兼 COO

関谷 毅 大阪大学 産業科学研究所 教授



JISSO PROTEC 特別講演

無料

●日 時：6月4日（水）～6日（金） ●会 場：セミナー会場 G ●聴講者数：全3セッション 632名

6月4日（水）			スマートフォン・周辺機器、AIサーバーの業界見通し
			中根 康夫 みずほ証券株式会社 エクティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ シニアアナリスト
6月5日（木）	10:30 }		サイバートラック（テスラ） 分解から読み解く電動車用パワー半導体実装技術トレンドと将来動向
	11:20		
			山本 真義 名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授
6月6日（金）			JEITA2024 年度版実装技術ロードマップ「注目される市場と電子機器群」
			西村 隆 一般社団法人電子情報技術産業協会 Jisso 技術ロードマップ専門委員会 委員長／ 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所先進パワーデバイス技術部 主席研究員



JIEP 最先端実装技術シンポジウム 有料

●日 時：6月4日（水）～6日（金） ●会 場：最先端実装技術シンポジウム A会場・B会場（会議棟 6F） ●聴講者数：3,722名

A 会場（会議棟605・606）		B 会場（会議棟607・608）	
	4A-1 5G/6G向け高周波対応材料開発動向 座長：松本 博文、高野 希	4B-1 半導体/PKG2025年展望 座長：土門 孝彰、鈴木 大地	
6月4日（水）	10:00-10:50 4A1-1 Beyond5Gに向けた高速通信用途向け基板材料の技術開発動向※ 広川 祐樹 パナソニック インダストリー(株) 電子材料事業部 電子基材ビジネスユニット 技術一部 技術一課 課長	4B1-1 2025年以降の電子機器と半導体市場トレンドを読む※ 南川 明 インフォーメインテリジェンス合同会社 コンサルティング シニアコンサルティングディレクター	
	10:50-11:40 4A1-2 5G/6Gに向けた低伝送損失基板材料の技術動向と評価技術 春日 圭一 (株)レゾナック エレクトロニクス事業本部 開発センター 積層材料開発部 上級研究員	4B1-2 成長のための『斬新なマーケティング戦略』※ 永田 隆一 アンカー・ビジネス・システムズ(株) 代表取締役社長	
	11:40-12:30 4A1-3 5G/6Gに向けたBTレジソ積層材料の技術開発動向 鹿島 直樹 三菱ガス化学(株) 研究統括部 東京研究所 主任研究員	4B1-3 新世代半導体パッケージ基板製造装置とプロセスのご紹介※ 山崎 瑛一朗 信越化学工業(株) 微小材料システム事業推進室 マネージャー	
	4A-2 光電融合技術の新潮流と最新動向 座長：中條 徳男、谷 元昭	4B-2 半導体とAI開発最新動向 座長：土門 孝彰、池田 浩昭	
	13:30-14:20 4A2-1 スーパーコンピュータのインターコネクト技術動向と 光電コパッケージ技術への期待 安島 雄一郎 富士通(株) 先端技術開発本部 システム開発統括部 プリンシパルアーキテクト	4B2-1 AIがもたらす半導体業界への影響 山本 義継 みずほ証券 エクティ調査部 シニアアナリスト	
	14:20-15:10 4A2-2 800Gbps/1.6Tbps 実現に向けての対応状況および技術課題 土屋 師子生 アリスタネットワークスジャパン合同会社 技術部 副技師長	4B2-2 半導体産業の明るい未来 和田木 哲也 Morgan Stanley MUFG 証券 調査統括本部 マネージングディレクター	
6月5日（木）	15:10-16:00 4A2-3 光×コンピューティングの研究動向 鯉淵 道敏 国立情報学研究所 アーキテクチャ科学研究系 教授	4B2-3 AI用半導体チップレットの最新動向 西尾 俊彦 SBRテクノロジー 代表取締役	
	5A-1 生成AIの最新動向、現状と課題 座長：西田 秀行、鈴木 大地	5B-1 高機能・高密度化を実現する先端配線技術の今 座長：佐藤 牧子、北原 悠平	
	10:00-10:50 5A1-1 AI Hardwareの現状と課題 山道 新太郎 日本アイ・ビー・エム(株) 東京基礎研究所 セミコンダクター 理事	5B1-1 高機能化を支える銅箔技術 森岡 伸哲 福田金属箔粉工業(株) 技術本部 研究開発部 EF研究グループ グループマネージャー	
	10:50-11:40 5A1-2 AIとコンピューティングの今とこれから※ 愛甲 浩史 エヌビディア合同会社 エンタープライズマーケティング部 シニアマーケティングマネージャ	5B1-2 微細配線対応銅めっきおよびエッチングプロセス 大野 晃宜 (株)JCU 総合研究所 執行役員 総合研究所 副所長	
	11:40-12:30 5A1-3 AI向けアクセラレータ開発と光インターコネクト、現状と課題※ 中止 平木 敬 Preferred Networks Senior Researcher	5B1-3 メックの導体表面処理技術の開発ロードマップ紹介と半導体向け 弊社技術の紹介 吉海 雅史 メック(株) マーケティング企画部 部長	
	5A-2 新パワーモジュール3D実装の動向 座長：土門 孝彰、加藤 義尚	5B-2 進化するパッケージ基板・インターポーザ 座長：谷 元昭、佐藤 牧子	
6月6日（金）	13:30-14:20 5A2-1 WBGパワーデバイスの3D実装と通信・エッジコンピューティングの 融合で広がるパワーエレ・アプリケーション 中村 和人 名古屋大学 未来材料・システム研究所 パワーエレクトロニクス研究室 STROM Lab 代表	5B2-1 先端半導体に対応した最新のパッケージ基板技術 栗田 健太郎 新光電気工業(株) 開発統括部 アドバンスパッケージ開発部 主幹研究員	
	14:20-15:10 5A2-2 パワーモジュールの高放熱化技術開発動向 山本 圭 三菱電機(株) 先端技術総合研究所 先進パワーデバイス技術部 パッケージング技術グループ グループマネージャー	5B2-2 Glass Substrate for Heterogeneous Integration 倉持 悟 大日本印刷(株) ファインパッケージング本部 フェロー	
	15:10-16:00 5A2-3 パワー半導体 GaN デバイスの社会実装を急加速させるための 取り組み※ 山口 雄平 ローム(株) LSI事業本部 電源・標準LSI事業担当 パワーステージ商品開発部 部長	5B2-3 チップレット集積 PSB（ピラサスペンディッドブリッジ）を中心とした アドバンスパッケージ群の半導体中工程技術について 河野 一郎 アオイ電子(株) FOLP事業部 参事	
	6A-1 CHIPLETの最新動向、現状と課題（Playerの取り組み） 座長：西田 秀行、森川 泰宏	6B-1 モビリティ・GXと実装技術 座長：三宅 敏広、武田 裕一	
	10:00-10:50 6A1-1 半導体後工程の未来：チップレットパッケージング技術の革新※ 折井 靖光 Rapidus(株) 専務執行役員・エンジニアリングセンター長	6B1-1 先端車載SOC用パッケージの技術動向～チップレット適用に向けて～ 渋谷 祐貴 Renesas Electronics Corporation Global Packaging & Assembly Division Package Research Center Principal Engineer	
	10:50-11:40 6A1-2 Customization & Energy-efficiency Improvement with Advanced Packaging for AI Infra※ 荻谷 隆 日本サムスン(株) Samsung デバイスソリューションズ研究所 Advanced Package Lab. Corporate Vice President, Top of Lab	6B1-2 カーボンニュートラルに向けた電動化とパワーエレクトロニクス 堀田 幸司 (株)ミライズテクノロジーズ 執行役員	
	11:40-12:30 6A1-3 AI/HPCの未来を拓く先端パッケージング技術※ 安原 隆太郎 TSMC ジャパン 3DIC 研究開発センター(株) プロセスインタラクション部門 テクニカルマネージャー	6B1-3 自動車電動化および自動運転に対応した樹脂材料 寺岡 尚信 ポリプラスチックス(株) テクニカルソリューションセンター グループリーダー	
	6A-2 CHIPLETの最新動向、現状と課題（Process/Architecture） 座長：西田 秀行、松澤 浩彦	6B-2 応用急拡大が期待されるフレキシブル・ストレッチャブル3D回路形成技術 座長：本多 進、小岩 一郎	
	13:30-14:20 6A2-1 CMP 温故知新・開発の歴史・必要性/必然性・言えない話（？） 辻村 学 (株)荏原製作所 コーポレート フェロー	6B2-1 ウェアラブルデバイスに応用する伸縮FPC（Stretchable FPC）技術 松本 博文 フレックスリンク・テクノロジー(株) 代表取締役社長	
	14:20-15:10 6A2-2 モールドイングの変遷と先端パッケージにおけるモールドイング技術 家治川 祐一 TOWA(株) 市場開発部 シニアリーダー	6B2-2 印刷法を用いたストレッチャブル・立体多層配線形成技術とその応用 鳥井 純一 (株)フジクラ 電子部品開発部 主席技師	
	15:10-16:00 6A2-3 ハイブリッド接合の業界/学会の最新動向、課題と期待について 井上 史大 横浜国立大学 半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター 准教授	6B2-3 アクアプラズマを用いたウルトラフレキシブルデバイスの実装技術と 応用例 横田 知之 東京大学 工学系研究科総合研究機構 准教授	



出展者セミナー

無料

1) 出展者 (NPI) プレゼンテーション

●日 時：6月4日 (水) ～6日 (金) ●会 場：セミナー会場D・J・K ●聴講者数：1,870名

●発表出展会社

旭化成(株) / アンドールシステムサポート(株) / (株)石井表記 / 上村工業(株) / エステック(株) / (株)オーク製作所 / 奥野製薬工業(株) / (株)オンテック / 協立化学産業(株) / (株)ケミトックス / サカタインクス(株) / (株)三共社 / 三見技研工業(株) / シストランジャパン (同) / 澁谷工業(株) / (株)SCREEN PEソリューションズ / ダイナトロン(株) / 長興材料工業(株) / ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン(株) / TDK(株) / テクノアルファ(株) / 東洋アルミニウム(株) / ナラサキ産業(株) / ニチアス(株) / 日本テルペン化学(株) / (株)ブルックスジャパン / 三井金属鉱業(株) / 三菱ガス化学(株) / 武蔵エンジニアリング(株) / メトロームジャパン(株) / ユニオンツール(株) / (株)ワンダーフューチャーコーポレーション

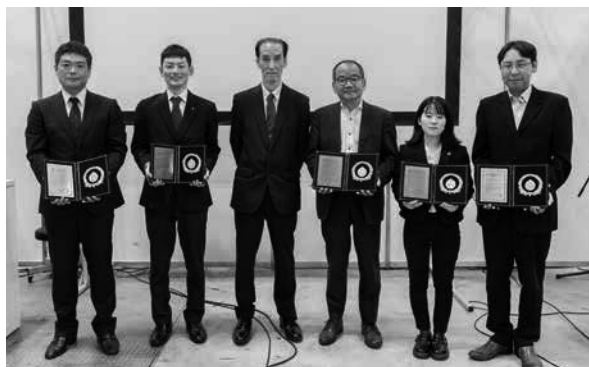
2) 第21回 JPCA 賞 (アワード) 受賞者

この度、JPCA 賞 (アワード) 選考委員会にて、厳正なる審査の上、第21回 JPCA 賞 (アワード) 受賞企業が下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。JPCA 賞 (アワード) は、参加企業の中から、応募のあった発表内容の『独創性 (独自性・オリジナリティ)』、『産業界での発展性・将来性』、『信頼性』、『時世の適合性』を審査基準として、学术界、電子回路業界、専門誌編集者等有識者の方々と構成する JPCA 賞 (アワード) 選考委員会によって厳正な審議を行い、電子回路技術及び産業の進歩発展に顕著な製品・技術への表彰制度として2005年より実施しています。

【表彰式】セミナー会場C ●日 時：6月4日 (水) 16:40～16:55

JPCA 賞	
■光プローブ式電流センサ (OpECS)	信州大学・シチズンファインデバイス株式会社・岩崎通信機株式会社
■車載半導体パッケージ向け高信頼性ドライフィルムタイプソルダーレジスト	太陽インキ製造株式会社
■低誘電マクロモノマー (スネクトン) の開発	デンカ株式会社

JPCA 奨励賞	
■環境調和型ドライプロセスによるフッ素系ポリマー粉体の水分散化と多分野への応用展開	株式会社魁半導体
■新技術を搭載したフライング式インサーキットテストの開発	タカヤ株式会社



3) 3D-MIDパビリオンセミナー

●日 時：6月4日 (水) ～6日 (金) ●会 場：セミナー会場E ●聴講者数：128名

●発表出展会社

三共化成(株) / (株)図研 / 電子情報技術産業協会 (JEITA) / (株)ワンダーフューチャーコーポレーション

4) PROTEC セミナー

●日 時：6月4日 (水) ～6日 (金) ●会 場：セミナー会場H ●聴講者数：595名

●発表出展会社：JUKI (株) / 千住金属工業(株) / パナソニック コネクト(株) / (株)FUJI / 武蔵エンジニアリング(株) / ヤマハ発動機(株)



5) アカデミックプラザ

●日 時：6月4日（水）～6日（金） ●会 場：セミナー会場E ●聴講者数：532名

●発表出展大学・研究機関等一覧

公立諏訪東京理科大学 機械電気工学科 / 群馬大学 / 群馬大学大学院理工学府 / 信州大学 工学部 電子情報システム工学科先端磁気デバイス（菅根原）研究室 / 東京工芸大学 / 東京工芸大学大学院 / 東京理科大学 / 東京理科大学 創域理工学部電気電子情報工学科 / 東京理科大学大学院 創域理工学研究科電気電子情報工学専攻 / 東北大学 / 東北大学大学院工学研究科 / 同志社大学大学院生 / 長野工業高等専門学校 / 日本大学 / 日本大学大学院理工学研究科 / 日本大学理工学部 / 日本大学理工学研究科 精密機械工学専攻 / 北海道大学 大学院工学研究院 米澤研究室 /

6) 🏆 2025アカデミックプラザ受賞者

アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、JIEP展示会委員会（越地委員長：東京工芸大学 工学部 総合工学系 電気電子コース、大学院 工学研究科 電子情報工学専攻、基礎教育研究センター 教授）で優秀な論文内容が選考され、アカデミックプラザ賞受賞者が決定いたしました。

【表彰式】セミナー会場E ●日 時：6月4日（水）16：40～17：00

■カーボンナノチューブを用いた電波吸収材料の遮断周波数制御に関する検討	東北大学大学院工学研究科 秋田大学情報データ科学部 秋田大学大学院理工学研究科 名古屋大学大学院工学研究科 / 株式会社ソラマテリアル
■ウェアラブルな塩分濃度計測センサによる全身喪失塩分量計測技術の開発	公立諏訪東京理科大学 機械電気工学科 ミツミ電機株式会社 カナルウォーター株式会社 株式会社フジタ
■MEMS マイクロロボットに実装可能なシリコンデバイスの開発	日本大学理工学研究科 精密機械工学専攻 日本大学理工学部 精密機械工学科



7) Electronics Component & Unit Show 出展者プレゼンテーション

●日 時：6月5日（木） ●会 場：セミナー会場D ●聴講者数：13名

●発表出展会社：コアスタッフ(株)



主催者セミナー

●ダントツものづくりセミナー

無料

●日 時：6月4日(水)～6日(金) ●会 場：セミナー会場C ●聴講者数：443名

6月4日(水)		6月5日(木)		6月6日(金)	
生産性向上ものづくりDX特別セッション		トヨタ式現場管理と改善取組・成果セッション		TOC/管理会計セッション	
13:00 ～ 13:45	 0604TK 【特別基調講演】生産性向上の時代における地域スクール/JPCAものづくりアカデミーの役割 藤本 隆宏 東京大学名誉教授/早稲田大学教授	13:00 ～ 13:45	 0605T3 【特別講演3】トヨタ式現場管理 田中 正知 トヨタ自動車OB ものづくり大学名誉教授/ J-コスト研究所代表	13:00 ～ 13:45	 0606T5 【特別講演5】飛躍的な生産性を実現する全体最適の働き方イノベーション 岸良 裕司 ゴールドラット・ジャパン CEO
13:45 ～ 14:30	 0604TK 【特別基調講演】賃金上昇、人手不足、原材料高騰の中での電子回路業界活性化は生産性向上しかない! 藤本 隆宏 東京大学名誉教授/早稲田大学教授	13:45 ～ 14:30	 0605T4 【特別講演4】現場改善のJコスト理論による強化策 (ROA) 田中 正知 トヨタ自動車OB ものづくり大学名誉教授/ J-コスト研究所代表	13:45 ～ 14:30	 0606T6 【特別講演6】月曜日が楽しみな会社にしよう! ～全体最適のマネジメント理論TOCとは～ 岸良 裕司 ゴールドラット・ジャパン CEO
14:35 ～ 15:20	 0604T1 【特別講演1】DX (デジタルトランスフォーメーション)による日本の製造業の競争力強化 一カ 知一 パナソニックコネクテ(株) エグゼクティブコンサルタント・エバンジェリスト/ 京都女子大学データサイエンス学部客員教授	14:35 ～ 15:35	 0605S1 ※ JPCAものづくり大賞/準大賞受賞 (2023年度) 改善取組事例報告3件 大賞受賞 (株)愛工機器製作所コア加工事業部春日井工場 準大賞受賞 (株)京写 九州工場/太陽インキ製造(株)埼玉工場	14:35 ～ 15:20	 0606T7 【特別講演7】電子回路ものづくり企業の「現場改善」について「お金の良い流れ」から考える 終 紫乃 愛知工業大学経営学部経営学科教授
15:20 ～ 16:05	 0604T2 【特別講演2】IE (インダストリアルエンジニアリング) とDXの融合は日本企業のDX成功の要件 一カ 知一 パナソニックコネクテ(株) エグゼクティブコンサルタント・エバンジェリスト/ 京都女子大学データサイエンス学部客員教授	15:40 ～ 16:10	 0605K1 【基調講演】人的資本を最大化するトヨタ方式「育て抜く」戦略 山本 治彦 JPCAものづくりアカデミー校長/ JPCA顧問・E-ESMAP研究会特別顧問	15:20 ～ 16:05	 0606T8 【特別講演8】経営者は何を管理すれば現場改善効果を見える化できるのか「現場改善会計 (GKC)」 終 紫乃 愛知工業大学経営学部経営学科教授

●ぷりんとばんじゅくセミナー

無料

●日 時：6月4日(水)・6日(金) ●会 場：セミナー会場B ●聴講者数：343名

6月4日(水)	13:00-14:00	プリント配線板全般の基礎“ぷりんとばんじゅくI”をもとに解説	榎場 正男 (株)カヤバオフィス 代表取締役
	14:15-15:15	プリント配線板設計の基礎“ぷりんとばんじゅくII”をもとに解説	田中 弘文 TNK エンジニアリング 代表
	15:30-16:30	フレキシブル配線板の基礎“ぷりんとばんじゅくVII”をもとに解説	宮崎 博明 元MFインフォメーション(株) 代表
6月6日(金)	12:30-13:30	実装の基礎“ぷりんとばんじゅくV”をもとに解説	榎場 正男 (株)カヤバオフィス 代表取締役
	13:45-14:45	品質管理の基礎	安井 博文 安井事務所 PWBコンサルタント

●主催者企画セミナー

無料

●日 時：6月4日(水)～6日(金) ●会 場：セミナー会場I ●聴講者数：38名

6月4日(水)～6日(金)	疲労ストレス計MF100による自律神経状態の見える化とその活用例		
13:00-14:00	家邊 徹 (株)村田製作所 医療・ヘルスケア機器製品部 マーケティング課 プリンシパルプロフェッショナル		
6月5日(木)	いのちを守る選択——“その瞬間”に備える 防災リスクサーベイゲーム 防災脳内訓練に挑戦!		
14:15-15:15	高貝 正芳 (一社)いのちを守る@プロジェクト JAPAN 代表理事		

●経済安全保障セミナー

無料

●日 時：6月4日(水) ●会 場：セミナー会場L ●聴講者数：23名

6月4日(水)	経済安全保障の確保に向けて ～不正活動に巻き込まれないために～		
13:00-15:00	森永 隆雄 公安調査庁 調査第二部第一課 国際調査企画官		



主催者セミナー

●JEITA半導体・チップレットセミナー 無料

●日 時：6月5日（木） ●会場：セミナー会場B ●聴講者数：186名

6月5日（木）	11:30-12:00	AI・チップレット等先端半導体パッケージング構造設計の現状と課題	吉田 浩芳 大阪大学 フレキシブル3D実装協働研究所 特任研究員
	13:00-13:30	IEC62433-3(ICEM-RE)と放射ノイズモデリング	金本 俊幾 弘前大学 理工学研究科 研究部 教授
	13:40-14:10	電源回路のEMI設計フロントローディング検証	野村 毅 コニカミノルタ(株)
	14:20-15:00	PIのフロントローディング	林 靖二 キヤノン(株)
	15:10-15:50	チップレット設計標準化動向	小島 智 コジマイーデザインオフィス 代表
	16:00-16:40	チップレットソリューションにおけるセキュリティ技術	永田 真 神戸大学 科学技術イノベーション研究科 教授

●PWBコンサルタントセミナー 有料

●日 時：6月5日（木） ●会場：セミナー会場K・L ●聴講者数：41名

6月5日（木）	10:30-12:00	知って得する営業員向けセミナー	一色 和彦／渡邊 喜夫／中山 務 JPCA PWBコンサルタント
	13:00-14:30	購入側から見たプリント配線板メーカーの選定方法（入門編）	鈴木 貴人／伊藤 直樹 JPCA PWBコンサルタント
	15:00-16:30	知って得する基板製造技術セミナー（中級編）	一色 和彦／渡邊 喜夫／保坂 三喜雄 JPCA PWBコンサルタント

●PWBコンサルタントスキルアップセミナー 無料

●日 時：6月6日（金） ●会場：セミナー会場L ●聴講者数：113名

6月6日（金）	15:00~16:45	対象 PWBコンサルタント、PWBインストラクタ1級・準1級資格保有者のみ	
---------	-------------	--	--

●E-Textile/Wearable展 基調講演 無料

●日 時：6月4日（水） ●会場：セミナー会場I ●聴講者数：42名

6月4日（水）	14:30-15:20	陸上自衛隊化学学校の研究におけるE-スマートテキスタイルの活用	大江 京子 陸上自衛隊 化学学校 研究部 装備研究科 主任研究官
---------	-------------	---------------------------------	----------------------------------

●E-Textile/Wearable展セミナー 無料

●日 時：6月4日（水）～6日（金） ●会場：セミナー会場I ●聴講者数：94名

6月4日（水）	10:30-11:10	WIZARDシリーズの紹介	井上 諒子 (株)ユシロ イノベーション推進部 マーケティングセクション 主査
	11:20-12:00	未来の空調服「カバロスウルトラフリーザーコア」	鈴木 素 hap(株) 代表取締役
6月5日（木）	10:30-11:10	100%再生セルロースを真空焼成した導電性繊維 ～フレキシビリティカーボンシート～	瀬戸 祐志 (株)中津山熱処理 R&B推進部 部長
	11:20-12:00	スマートテキスタイルの力：快適さと感動を創る新しい日常	松本 正秀 (株)三機コンシス 代表取締役
	15:15-16:05	E-スマートテキスタイルに関する国際標準化動向と社会実装にむけての課題	前田 郷司 広島市立大学 大学院情報科学研究科 研究員
6月6日（金）	10:30-11:10	都産技研のスマートテキスタイルに関する研究と応用事例の紹介	唐木 由佑 (地独) 東京都立産業技術研究センター 企画部 連携企画室 技術評価係 係長
	11:20-12:00	t-テキスタイル製品化研究会の紹介	佐脇 政孝 (地独) 東京都立産業技術研究センター 特任技術アドバイザー



主催者セミナー

● 2025 半導体・オブ・ザ・イヤー2025

【表彰式】 セミナー会場 G ●日 時：6月4日（水） 14:00～17:00

半導体オブ・ザ・イヤー2025は、2024年4月～2025年3月の間に発表された新製品・新技術の中から産業タイムズ社にて厳正に選出いたしました。

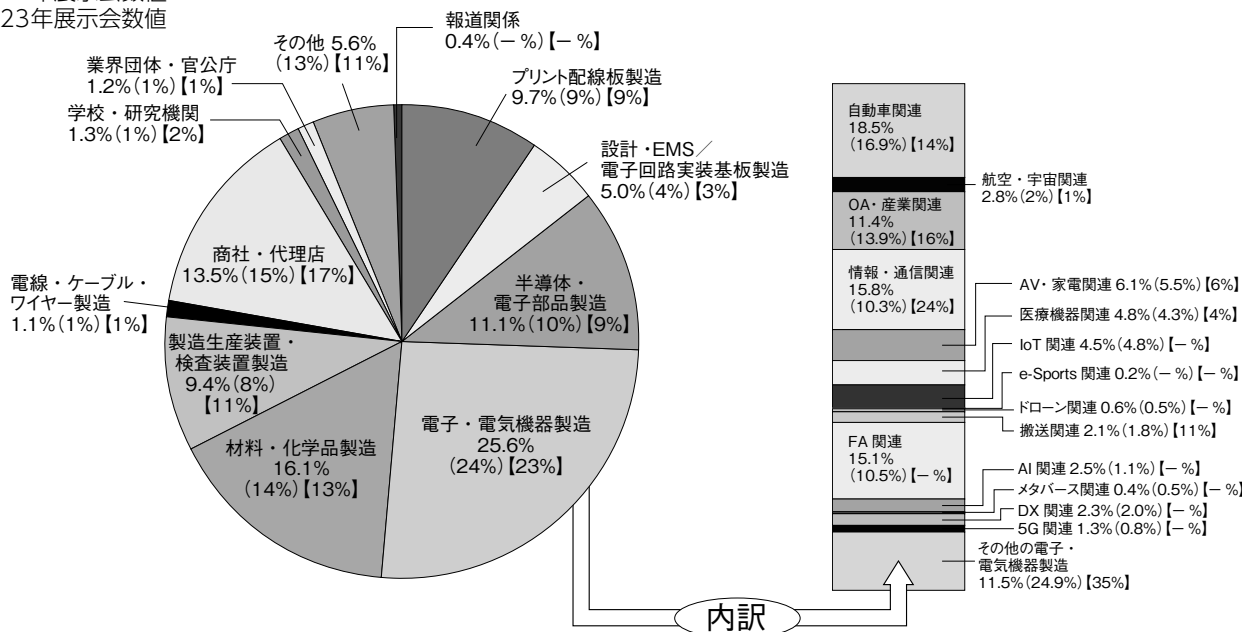
【半導体デバイス部門】		
グランプリ	インフィニオン テクノロジーズ	世界初の300 mm パワー GaN 技術
優秀賞	日清紡マイクロデバイス株式会社 沖電気工業株式会社	薄膜アナログICの3次元集積～アナログ積層回路技術とCFB技術の融合～
	TDK株式会社	スピントロニクス技術を用いたニューロモルフィック素子「スピンメモリスタ」
【半導体製造装置部門】		
グランプリ	沖縄科学技術大学院大学	エネルギー効率を飛躍的に高める革新的なEUVリソグラフィー先端半導体製造技術
優秀賞	株式会社LE-TECHNOLOGY	アドバンスドパッケージ用ダイレクト露光装置「LAMBDI」
	東レエンジニアリング株式会社 東レエンジニアリング先端半導体MIテクノロジー株式会社	パネルレベルパッケージ用の検査、塗布、実装各装置の開発・展開
【半導体用電子材料部門】		
グランプリ	SICC Co., Ltd.	世界初の300mm SiC ウエハー
優秀賞	三井化学株式会社	ハイブリッド接合の低温化に向けた絶縁樹脂の開発
	三菱マテリアル株式会社	半導体パッケージ向け「角型シリコン基板」



来場者分析

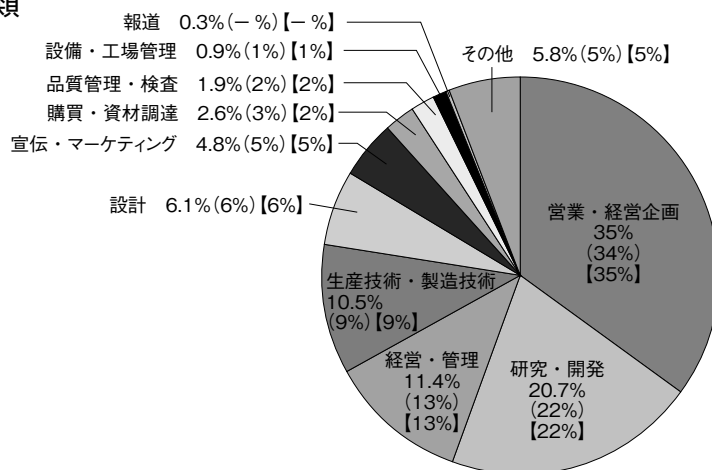
①来場者の業種分類

() 2024年展示会数値
【 】2023年展示会数値



②来場者の職種分類

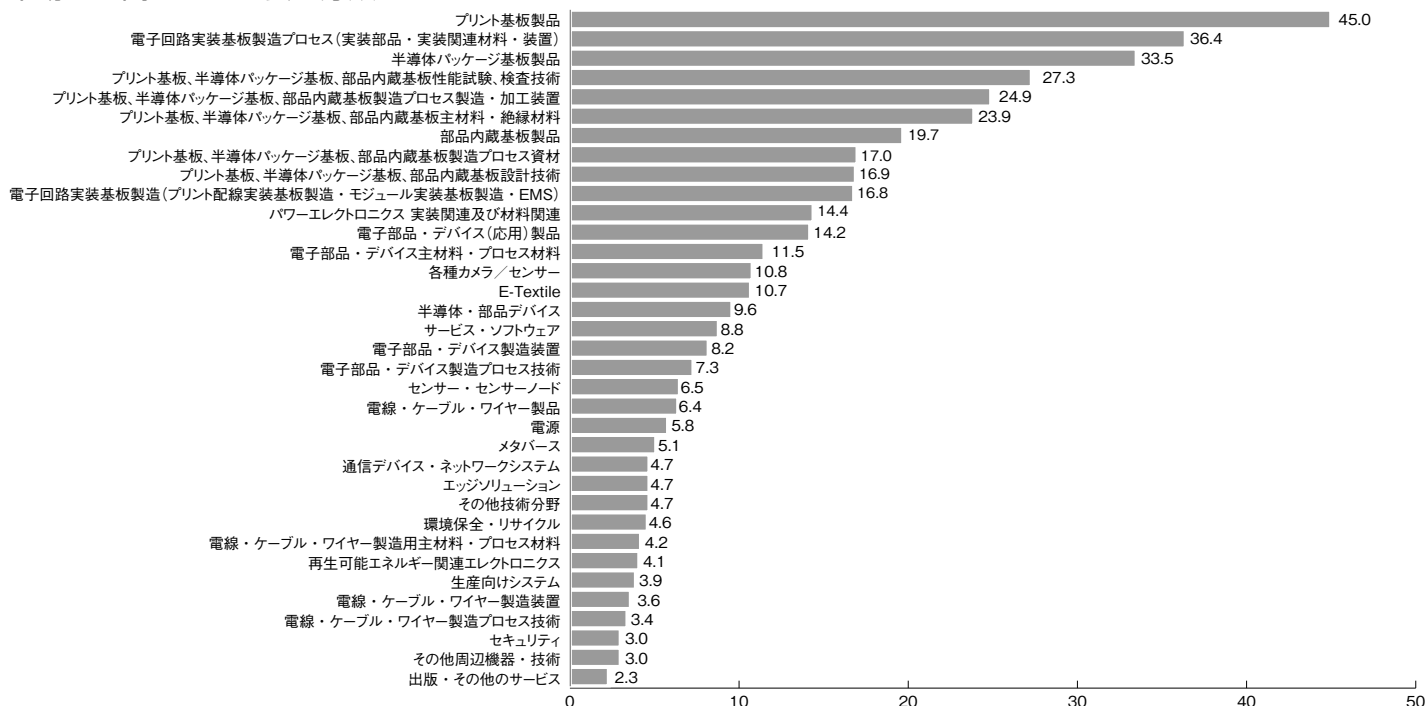
() 2024年展示会数値
【 】2023年展示会数値



本展は総合展示会のため電子機器に関する幅広い業種の方々に来場いただき、なかでも電子・電気機器製造の方が多い。特に情報通信関連、ファクトリーオートメーション関連の伸びが大きい。

また、製品分類においては、プリント配線板製品、電子回路実装基板製造、半導体パッケージング製品への関心が高い。

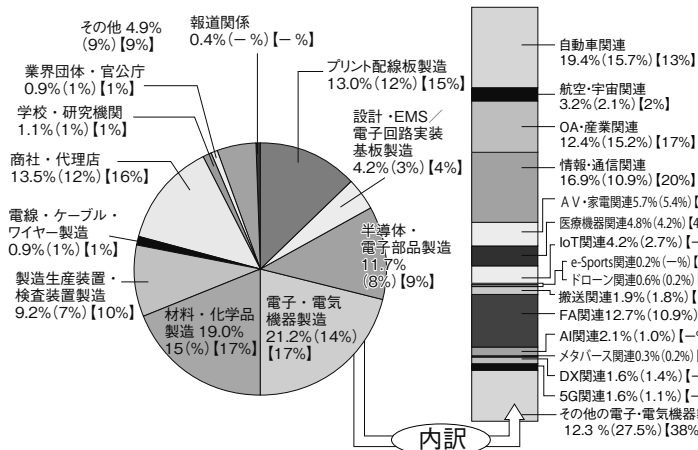
③来場者が関心のある製品分類 ※複数回答



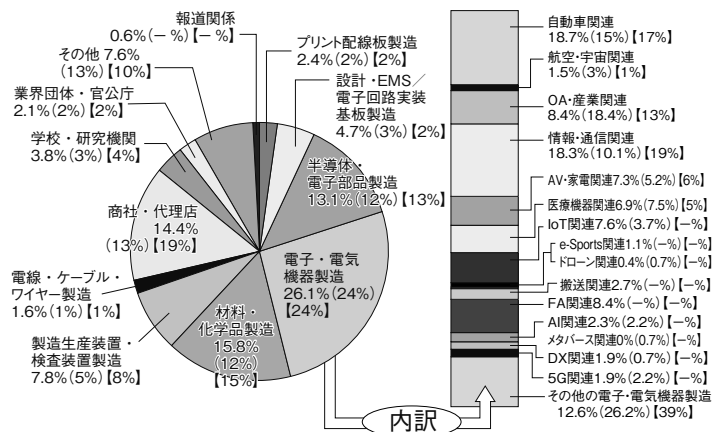


来場者分析

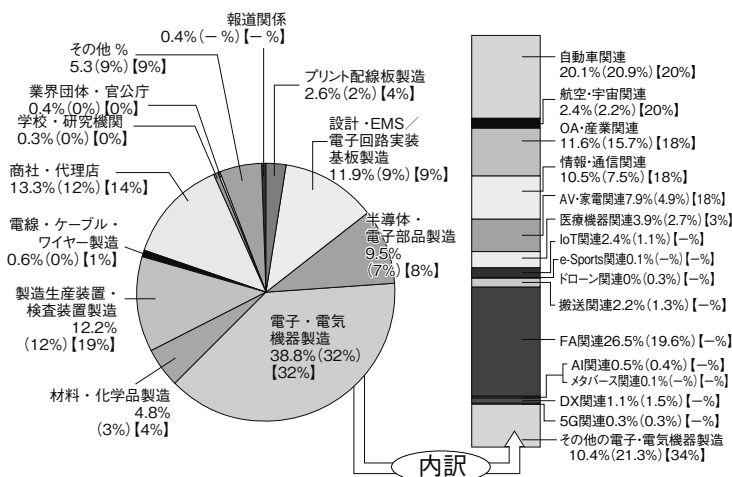
JPCA Show 2025 () 2024年展示会数値 [] 2023年展示会数値



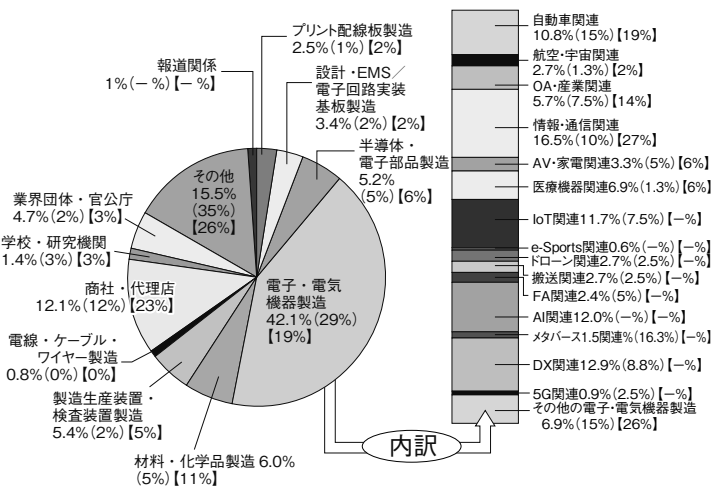
2025 マイクロエレクトロニクスショー () 2024年展示会数値 [] 2023年展示会数値



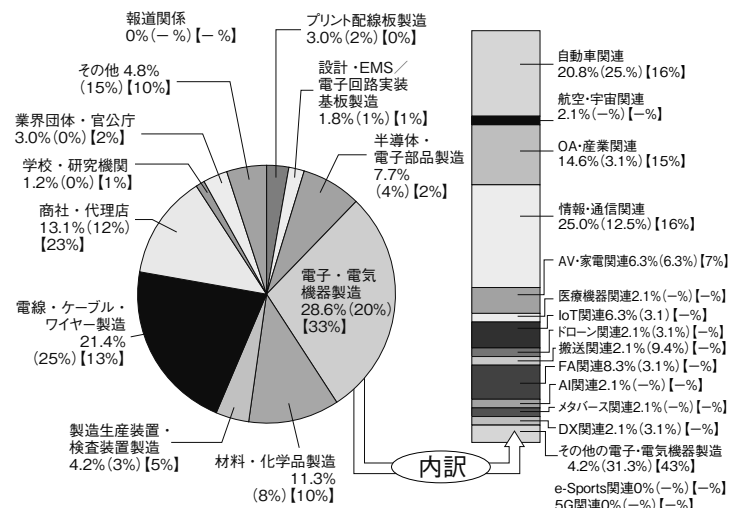
JISSO PROTEC 2025 () 2024年展示会数値 [] 2023年展示会数値



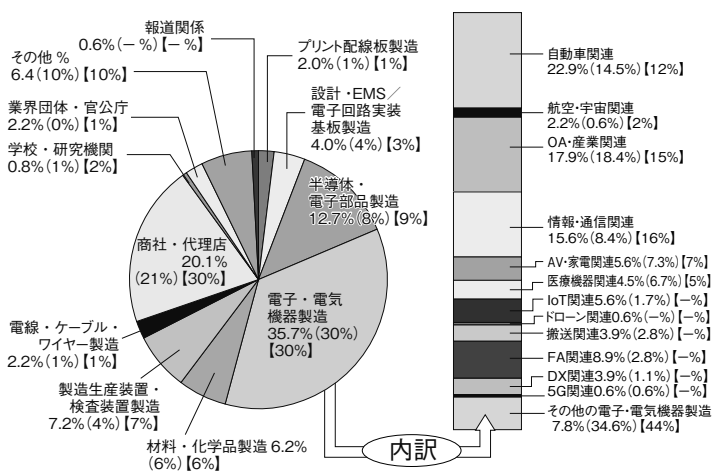
AI Device Expo () メタバースデバイス展2024数値 [] SDGsデバイス展2023数値



WIRE Japan Show 2025 () 2024年展示会数値 [] 2023年展示会数値



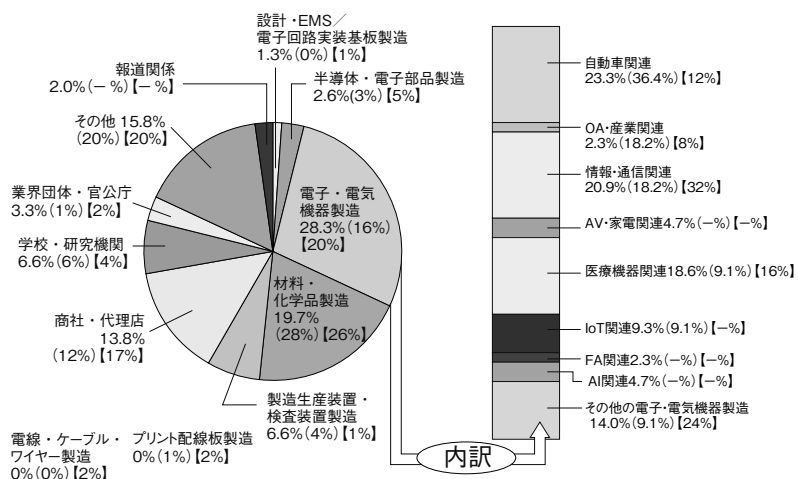
Electronics Component & Unit Show () 2024年展示会数値 [] 2023年展示会数値





来場者分析

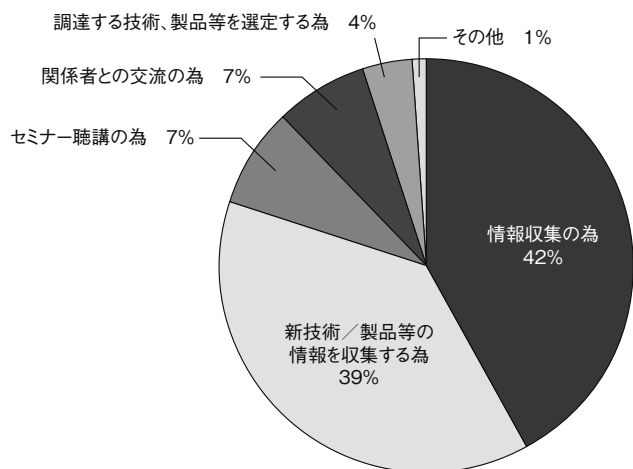
E-Textile/Wearable () 2024年展示会数値
() 2023年展示会数値



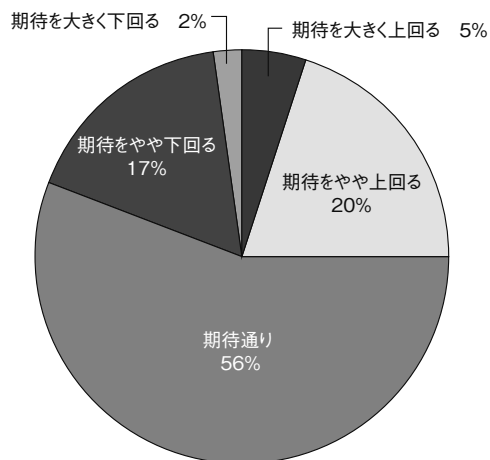


来場者アンケート

① 来場目的

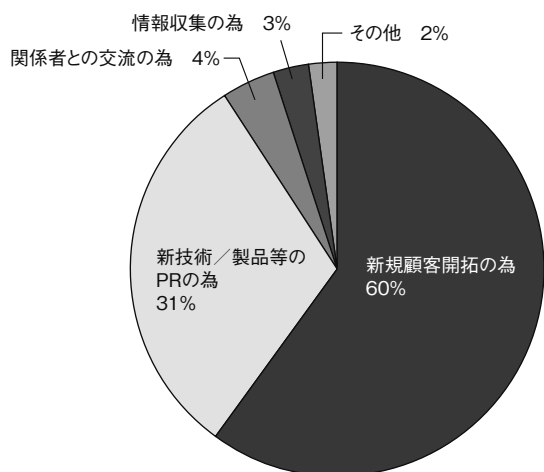


② 来場成果

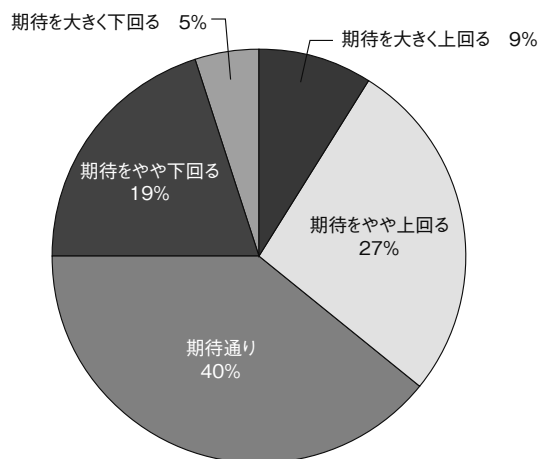


出展者アンケート

① 出展目的



② 出展成果





2025年展示会主催・運営委員会 委員

2025展示会運営委員会

委員長	高井 健郎	JPCA 副会長／太陽ホールディングス(株)
副委員長	小島 正紀	JPCA 副会長／ニッカン工業(株)
委員	松澤 浩彦	JIEP 展示会運営委員会委員長／(株)図研
委員	高橋 良太郎	JISSO PROTEC 2024運営委員会 委員長／パナソニックコネクスト(株)
委員	泉谷 渉	AIデバイス展共催会社会長／(株)産業タイムズ社 (電子デバイス産業新聞)
委員	井上 政基	WIRE Japan Show 共催会社社長／(株)工業通信 (電線新聞)
委員	川鍋 季明	Electronics Component & Unit Show 共催団体代表／(株)三共社
委員	久本 正大	E-Textile/Wearable 共催会社代表／(株)織研新聞社

JIEP 展示会運営委員会

委員長	松澤 浩彦	(株)図研
副委員長	佐藤 牧子	ナミックス(株)
	渡辺 隆史	(一社) 日本電子回路工業会
委員	松本 博文	フレックスリンクテクノロジー(株)
	土門 孝彰	秋田銀行
	三宅 敏広	車載エレクトロニクス実装研究所
	高野 希	(株)レゾナック
	齊藤 雅之	元(株)東芝
	池田 浩昭	日本航空電子工業(株)
	中條 徳男	東京科学大学
	谷 元昭	T2リサーチ
	加藤 義尚	福岡大学
	森川 泰宏	(株)アルバック
	北原 悠平	奥野製薬工業(株)
	内木場文男	日本大学
	小岩 一郎	関東学院大学
	越地 福朗	東京工芸大学
	白石 洋一	群馬大学
	金谷 春一	九州大学

2025展示会企画委員会

委員長	石川 雅昭	JPCA 理事／超高効率電子回路生産システム研究会
副委員長	小島 正紀	JPCA 副会長／ニッカン工業(株)
副委員長	ジュリアン・ベイショア	JPCA 理事／ボド・メラ・ケミー・ジャパン(株)
委員	松澤 浩彦	JIEP 展示会運営委員会委員長／(株)図研
委員	高橋 良太郎	JISSO PROTEC 2025運営委員会 委員長／パナソニックコネクスト(株)
委員	泉谷 渉	AIデバイス展共催会社会長／(株)産業タイムズ社 (電子デバイス産業新聞)
委員	井上 政基	WIRE Japan Show 共催会社社長／(株)工業通信 (電線新聞)
委員	岡本 崇義	Electronics Component & Unit Show 代表／岡本無線電機(株)
委員	久本 正大	E-Textile/Wearable 共催会社代表／(株)織研新聞社

実装プロセステクノロジー展運営委員会

委員長	高橋 良太郎	パナソニックコネクスト(株)
副委員長	富士原 寛	(一社) 日本ロボット工業会
委員	五十棲 丈二	(株)FUJI
委員	北口 浩嗣	JUKI オートメーションシステムズ(株)
委員	江頭 綾子	ヤマハ発動機(株)

実装プロセステクノロジー展実行委員会

委員長	菅原 祐平	パナソニックコネクスト(株)
副委員長	後藤 巨樹	(株)FUJI
委員	公文 暁子	JUKI オートメーションシステムズ(株)
委員	飯塚 剛朗	ヤマハ発動機(株)
委員	宮部 大樹	武蔵エンジニアリング(株)
委員	伊佐 吉史	オムロン(株)

実装プロセステクノロジー展企画部会

委員長	菅原 祐平	パナソニックコネクスト(株)
副委員長	後藤 巨樹	(株)FUJI
委員	公文 暁子	JUKI オートメーションシステムズ(株)
委員	飯塚 剛朗	ヤマハ発動機(株)

JPCA 2026 Show
第55回 国際電子回路産業展

JIEP 2026
マイクロエレクトロニクスショー
第40回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC 2026
第27回 実装プロセステクノロジー展

AI Device Expo
AIデバイス展

～装置と装置をつなぐ～
WIRE Japan Show 2026
電気・光伝送技術展

Electronics Component & Unit Show
JESD 全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

E-Textile/Wearable
イーテキスタイル/ウェアラブル展



電子機器2026 トータルソリューション展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment 2026

2026. 6.10_{Wed.} → 12_{Fri.}

東京ビッグサイト 東展示棟 | Tokyo Big Sight, East Exhibition Halls

本部事務局 一般社団法人 日本電子回路工業会

Organizer: **JPCA**-Japan Electronics Packaging and Circuits Association

展示会に関するお問い合わせ／Inquiry

TEL : 03-5310-2020 E-mail : show@jpca.org

www.jpcaashow.com

詳細は展示会ウェブサイトへ ▶ www.jpcaashow.com/

▶ お問い合わせ先

本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F

TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org